

TC READ / WRITE UNIT MODIFICATION KIT

ANWENDUNG

Dieses Modifikationskit ist für Bandmaschinen der Typen A810, A812 und A820 mit Timecode bestimmt. Das Printlayout der eingebauten "TC Read/Write Unit" muss auf dem Stand 1.820.721.14 sein.

APPLICATION

This modification kit is suitable for all A810, A812 and A820 machines with Time Code facility. The already installed TC Read/Write Unit must have the Layout 1.820.721.14.

EINBAU

Benötigtes Werkzeug:

- Seitenschneider
- Lötkolben
- Lötspatula

Vorbereitungen:

- Frontabdeckung der Audio- und Steuerelektronik öffnen.
- Die Platine CODE READ/WRITE UNIT 1.820.721.85 oder .86 herausziehen.

UMBAU (vgl. Fig. 1 und 2)

- R79 entfernen
- R77 ersetzen durch D31 Z; 7,5V; 5%; 40W; (Nr. 50.04.1103)
- Q8 (WP146) entfernen
- C47 (47 μ F) entfernen
- R41 (1k Ω) entfernen
- D11 (IN4448) entfernen
- C27 (0,01 μ F) entfernen
- R82 47 Ω ersetzen durch R 150 Ω ; 1%; MF (Nr. 57.11.3151)
- R96 (1k Ω) entfernen
- R97 (2,4k Ω) entfernen
- C48, 47 μ F, ersetzen durch C 0,047 μ F; 10%; 63V; PETP (Nr. 59.06.0473)
- R78, 820 Ω , ersetzen durch R 15 Ω ; 1%; MF (Nr. 57.11.3150)
- Q7, BC 237B, ersetzen durch VN 0808 M (Nr. 50.03.1505)
- Die Punkte 18 und 28 mit W18 verbinden.
- Die Punkte 19 und 29 mit W19 verbinden.
- Die Punkte 29 und 30 mit W20 verbinden.
- Die Platine "Relais Extended Board" einbauen. (Stifte in Punkte 14,15,16,17)
- Punkt 11 (Relais Extended Board) mit Punkt 21 (TC Read/Write Unit) verbinden. (W11)
- Punkt 12 (Relais Extended Board) mit Punkt 22 (TC Read/Write Unit) verbinden. (W12)

INSTALLATION

Required tools:

- Side cutter
- Solder iron
- Solder sucking wick

Preparation:

- Open the electronics flap below the tape transport.
- Pull out the CODE READ/WRITE UNIT 1.820.721.85 or .86.

MODIFICATION (see fig. 1 and 2)

- Remove R79
- Remove R77 and replace by D31 Z; 7.5V; 5%; 40W (No. 50.04.1103)
- Remove Q8 (WP146)
- Remove C47 (47 μ F)
- Remove R41 (1k Ω)
- Remove D11 (IN4448)
- Remove C27 (0.01 μ F)
- Remove R82 47 Ω and replace by R 150 Ω ; 1%; MF (No. 57.11.3151)
- Remove R96 (1k Ω)
- Remove R97 (2.4k Ω)
- Remove C48, 47 μ F and replace by C 0.047 μ F; 10%; 63V; PETP (No. 59.06.0473)
- Remove R78, 820 Ω and replace by R 15 Ω ; 1%; MF (No. 57.11.3150)
- Remove Q7, BC 237B and replace by VN 0808 M (No. 50.03.1505)
- Link points 18 and 28 (W18)
- Link points 19 and 29 (W19)
- Link points 29 and 30 (W20)
- Set on the Relais Extended Board (pins to the points 14/15/16/17)
- Link points 11 (Relais Extended Board) and 21 (W11)
- Link points 12 (Relais Extended Board) and 22 (W12)

- Punkt 13 (Relais Extended Board) mit Punkt 23 (TC Read/Write Unit) verbinden. (W13)
- Auf der Lötseite C57; InF; SMD (Nr. 59.60.0102) wie in Fig. 1 und 2 dargestellt einfügen.
- Etiketle auf Index .87 erhöhen.
- Link points 13 (Relais Extended Board) and 23 (W13)
- Add C57; InF; SMD (No. 59.60.0102) on the solder side of the board as shown in fig. 1 and 2.
- Change the label to index .87.

Fig. 1: Zu entfernende Bauteile / Components to be removed

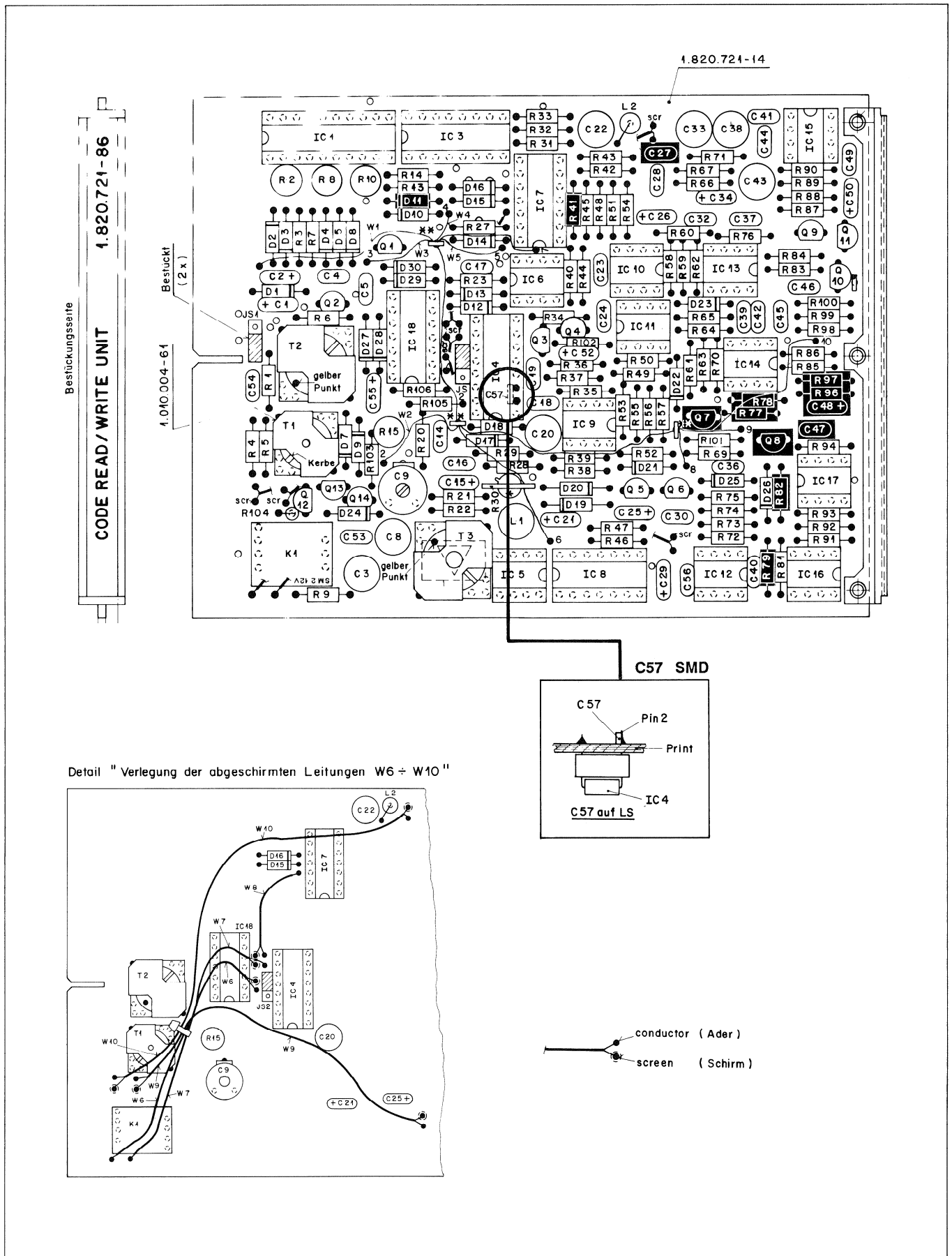


Fig. 2: Neue Bauteile / New components

